



tesa[®] HAF 8410 HS



Produkt Information

Varmeaktiveret film til indsættelse af chip-moduler i smart-kort

Produktbeskrivelse

tesa[®] HAF 8410 HS er en varmeaktiveret dobbelklæbende brun klæbefilm baseret på reaktiv phenolinrensins og nitrilgummi.

Ansøgning

tesa[®] HAF 8410 HS er designet til indsættelse af chipmoduler i smartkort med høje krav til sikkerhed og lang holdbarhed.

- Velegnet til PVC-, ABS-, PET- og PC-kort
- God bearbejdelighed på alle almindelige indsættelseslinier
- Enestående aldersbestandighed
- Livslang fleksibilitet på grund af det høje indhold af gummi

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|-------|
| • Linertype | Glassine | • Total tykkelse | 60 µm |
| • Bæremateriale | Ingen | • Farve | amber |
| • Klæbertype | Nitrilgummi /
fenolharpiks | | |

Egenskaber

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • Bonding strength (dynamic shear) | 12 N/mm ² |
|------------------------------------|----------------------|

Yderligere information

Tekniske anbefalinger til anvendelse på smartkort:

Følgende værdier udgør anbefalingerne for de maskinparametre, man starter med. Bemærk venligst, at de optimale parametre i høj grad afhænger af maskintypen, specielle materialer til karosserier og chipmoduler samt kundekrav.

1. Præ-laminering:

Under præ-lamineringen lamineres tapen på modulbæltet. Dette trin kan udføres inline eller offline. Prælamineringstrinet påvirker ikke tapens opbevaringstid. Præ-laminerede modulbælter kan opbevares i lige så lang tid som tapen.

Maskinindstilling:

- Temperatur 120 – 140 °C
- Tryk 4 – 6 bar
- Tid 1,5 – 3,0 s

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=08410>



tesa[®] HAF 8410 HS

Produkt Information

Yderligere information

2. Indsættelse af modul:

Under indsættelsen af modulet udstanses de præ-laminerede moduler fra modulbæltet, positioneres i korthullet og fastklæbes permanent til kortkroppen ved opvarmning. Hvad angår dette trin, afhænger den nøjagtige håndtering af typen af anvendt indsættelseslinie. I dag er følgende to metoder de mest almindelige;

Et-trins-procedure - Maskinindstilling (lav temperatur):

- Temperatur¹ 160 – 180 °C
- Tryk 65 N/modul
- Tid 2,0 – 4,0 sek.

Et-trins-procedure - Maskinindstilling (høj temperatur):

- Temperatur¹ 180 – 200 °C
- Tryk 65 N/modul
- Tid 1,0 – 1,5 sek.

Flertrinsprocedure (2 eller flere varmetempler) - Maskinindstilling:

- Temperatur¹ 170 – 200 °C
- Tryk 65 N/modul
- Tid (for hvert trin) 0,7 – 1,2 sek.

¹ Temperatur målt inde i varmetemplet

Ved anvendelse til andet end smartkort skal der anvendes andre maskinparametre. Opbevaringsbetingelser i henhold til tesa[®] HAF opbevaringstidskoncept.

Bemærk: Bindestyrkeværdierne er opnået under almindelige laboratorieforhold (middelværdier). Værdien er den garanterede frigøringsgrænse, som er afprøvet for hver produktionsbatch (materiale: Ætset aluminium testprøve / Klæbebetingelser: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min.)

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=08410>